～高密度実装技術の現状から
配線パターン設計の実例まで～

実装で失敗しないための基板設計術

実装技術が注目を集めています．競合に差を付ける手段の一つとして，機器の小型化が求められ，小型化にはプリント基板の小型化・高密度化が求められます．プリント基板を高密度化するためには，外形が小さい部品や特殊な構造を持つ部品を正確に搭載する技術や，搭載しやすい配線パターンの設計テクニックが必須です．本特集では，高密度実装の現状と起こりうる問題点，その対処法などについて解説した後，高密度実装のために生まれた新しい部品や技術を搭載するためのプリント配線板の配線パターンについて解説します．